

RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Asortyment produktów obejmuje następujące konstrukcje:

- 90°, leżąca (pozioma) oraz 180°, stojąca (pionowa)
- górny zatrzask / dolny zatrzask
- Procesy lutowania THT, THR lub SMD
- Szeroki wybór różnorodnych konstrukcji, także z wbudowanymi kontrolkami LED oraz zaciskami ekranu
- Kategoria działania Cat. 3 do Cat. 6
- Pakowane na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)
- Kompatybilny ze złączem modułowym RJ45, zgodnie z ANSI / TIA-1096-A oraz IEC 60603
- Wytrzymałość dielektryczna ≥ 1500 V AC RMS (wartość szczytowa 2250 V AC) zgodnie z IEEE 802.3
- Wytrzymałość dielektryczna ≥ 1500 V AC (wartość szczytowa) lub ≥ 1500 V DC zgodnie z IEC 60603

Właściwości i zalety:

- Rozszerzony zakres temperaturowy od -40° degC do $+85^{\circ}$ degC dla maksymalnej wydajności
- Wzmocniona warstwa złota (30μ) dla lepszego zabezpieczenia przed korozją
- Odstęp minimum 0,3 mm zapewnia idealne rezultaty lutowania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe do druku, Gniazda RJ45, Połączenie lutowane THT/THR, 180°, Liczba biegunów: 8
Nr zam.	2634590000
Typ	RJ45C6 R1V 3.2N4N TY
GTIN (EAN)	4050118651270
Ilość	140 Szt.

RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	7,475 g
------------	---------

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	1500 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1000 V DC
--------------------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------

Specyfikacje systemu

Cykle wpinania	750	Liczba biegunów	8
Powierzchnia ekranu	niklowany	Proces lutowania	Lutowanie rozpliwowe, Lutowanie ręczny, Lutowanie falowe
Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazdo modułowe RJ45	Stopień ochrony	IP20
kąt odejścia	180°	montaż na płycie drukowanej	Połączenie lutowane THT/ THR

Opakowanie

Długość VPE	0,315 m	Szerokość VPE	0,195 m
Wysokość VPE	0,065 m		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format
------------------	--

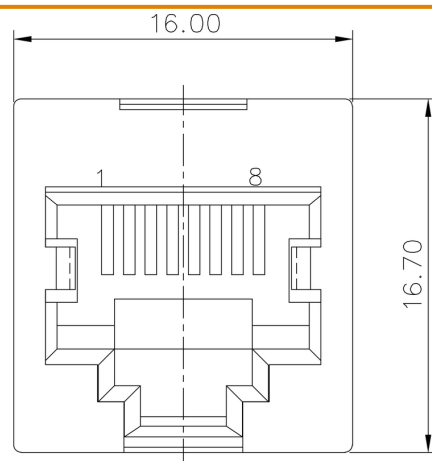
RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

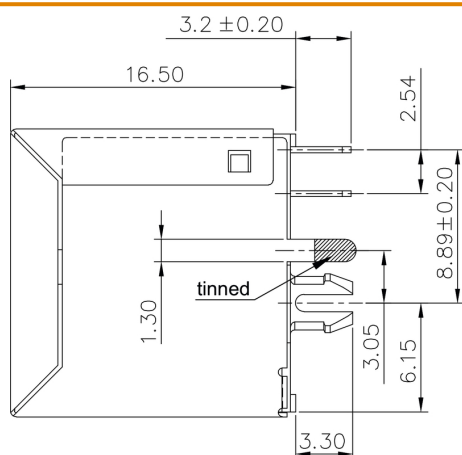
www.weidmueller.com

Rysunki

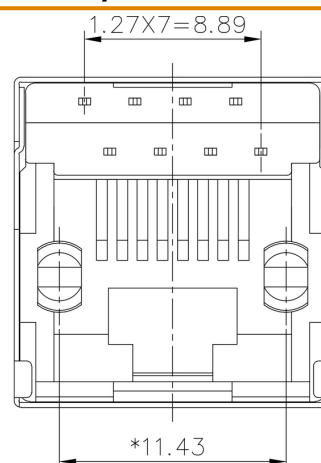
Rysunek wymiarowy



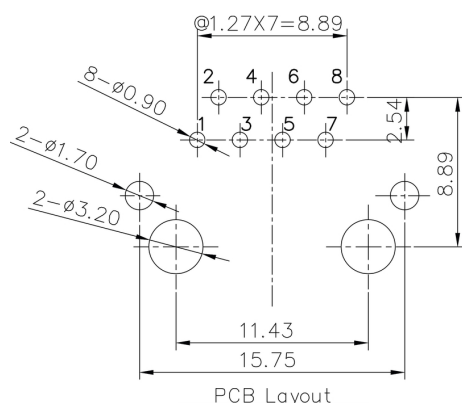
Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Układ płytek obwodu drukowanego



RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

RJ45	G	R	I	U	3	E	4	G/Y/GY	T	J45G1 R1 U3 E4 G/Y/GY T
								Packaging	TY RL	Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)
								LED	Y/G G/Y GY/GY O/O R/O ... N	Yellow/Green Green/Yellow (standard) Yellow/Green-Yellow Orange-Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED
								Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
								EMI tabs (ground fingers)	E N	E = with EMI tabs N = without EMI tabs
								Solder Pin length	3.2 1.6 D	3.2 mm 1.6 mm SMD
								Direction, latch style	U D V Y	Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up
								Number of Ports	1 12; 14; ... 21; 41; ...	1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel
								Assembly on PCB	R S T	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave
								Performance Category	C5 C6 CSA C5e M G1 G10 U NP NP+	Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+

Legenda

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 05:47:41 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.